

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二四年第二季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2024年8月8日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二四年六月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零二四年第二季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 4.785 亿美元，上年同期为 6.314 亿美元，上季度为 4.600 亿美元。
- 毛利率 10.5%，上年同期为 27.7%，上季度为 6.4%。
- 母公司拥有人应占溢利 670 万美元，上年同期为 7,850 万美元，上季度为 3,180 万美元。
- 基本每股盈利 0.004 美元，上年同期为 0.060 美元，上季度为 0.019 美元。
- 净资产收益率（年化）0.4%，上年同期为 10.0%，上季度为 2.0%。

二零二四年第三季度指引

- 我们预计销售收入约在 5.0 亿美元至 5.2 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 10%至 12%之间。

总裁致辞

公司总裁兼执行董事唐均君先生对 2024 年第二季度业绩评论道：

“半导体市场正在经历从底部开始的缓慢复苏。在经历了数个季度的持续疲软后，市场在部分消费电子等领域的带动下出现了企稳复苏信号。2024 年第二季度，华虹半导体的销售收入达到 4.785 亿美元、符合指引，毛利率为 10.5%、优于指引，均实现了环比增长。产能利用率也较上季度进一步提升，已接近全方位满产，巩固了公司在特色工艺晶圆代工工业界的领先地位。”

唐总继续表示：“公司第二条 12 英寸生产线的建设正在紧锣密鼓地推进中，预计年底前可以试生产，届时公司的产能及特色工艺平台将得到进一步的拓展和提升、挖掘出更大的潜力。华虹半导体将持续推进工艺技术的研发，不断夯实并力争扩大自身在特色工艺领域的优势，为市场和广大投资者带来更出色的营运表现和更丰厚的投资回馈。”

电话会议公告

- 日期 2024 年 8 月 8 日，星期四
- 时间: 17:00 香港/上海时间
05:00 美国东部时间
- 发言人: 唐均君，总裁兼执行董事
王鼎，执行副总裁兼首席财务官
- 广播: 会议将在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/xyz2ewz> 作线上直播
(请提前注册登记)
- 电话直拨: 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。
<https://register.vevent.com/register/BI7aacc9bd162f42aaa1d911212b0f5476>
重要提示: 在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。
- 网上回放: 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。
http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等“8 英寸 + 12 英寸”特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 月产能约 18 万片。另在无锡高新技术产业开发区内建有一座月产能 9.45 万片的 12 英寸晶圆厂 (“华虹无锡”), 这不仅是全球领先的 12 英寸特色工艺生产线, 也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。目前, 本公司正在推进华虹无锡二期 12 英寸芯片生产线 (“华虹制造”) 的建设。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	478,524	631,381	459,986	(24.2)%	4.0 %
毛利	50,063	175,056	29,632	(71.4)%	68.9 %
毛利率	10.5 %	27.7 %	6.4 %	(17.2)	4.1
经营开支	(90,328)	(76,668)	(78,520)	17.8 %	15.0 %
其他收入/(损失)净额	6,885	(54,709)	3,770	(112.6)%	82.6 %
税前(损失)/溢利	(33,380)	43,679	(45,118)	(176.4)%	(26.0)%
所得税(开支)/抵免	(8,368)	(35,845)	19,832	(76.7)%	(142.2)%
期内(损失)/溢利	(41,748)	7,834	(25,286)	(632.9)%	65.1 %
净利润率	(8.7)%	1.2 %	(5.5)%	(9.9)	(3.2)
以下各方应占利润:					
母公司拥有人	6,673	78,524	31,818	(91.5)%	(79.0)%
非控股权益	(48,421)	(70,690)	(57,104)	(31.5)%	(15.2)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.004	0.060	0.019	(93.3)%	(78.9)%
摊薄	0.004	0.060	0.019	(93.3)%	(78.9)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,106	1,074	1,026	3.0 %	7.8 %
产能利用率 ¹	97.9 %	102.7 %	91.7 %	(4.8)	6.2
净资产收益率 ²	0.4 %	10.0 %	2.0 %	(9.6)	(1.6)

二零二四年第二季度

- 销售收入 4.785 亿美元, 上年同期为 6.314 亿美元, 主要由于平均销售价格下降, 上季度为 4.600 亿美元, 主要得益于付运晶圆数量上升。
- 毛利率 10.5%, 上年同期为 27.7%, 主要由于平均销售价格下降, 上季度为 6.4%, 主要由于产能利用率提升。
- 经营开支 9,030 万美元, 同比上升 17.8%, 主要由于新工厂华虹制造经营费用及研发工程片开支上升, 环比上升 15.0%, 主要由于人工开支增加。
- 其他收入净额 690 万美元, 上年同期为其他损失净额 5,470 万美元, 主要由于汇兑损失减少及利息收入增加, 环比上升 82.6%, 主要由于利息收入增加, 部分被汇兑损失增加所抵消。
- 所得税开支 840 万美元, 同比下降 76.7%, 主要由于本季度应课税利润下降; 上季度为所得税抵免, 主要由于上季度转回以前年度计提的代扣代缴股息税所致。
- 期内损失 4,170 万美元, 上年同期为期内溢利 780 万美元, 上季度为期内损失 2,530 万美元。
- 母公司拥有人应占溢利 670 万美元, 上年同期为期内溢利 7,850 万美元, 上季度为 3,180 万美元。
- 基本每股盈利 0.004 美元, 上年同期为 0.060 美元, 上季度为 0.019 美元。
- 净资产收益率 (年化) 0.4%, 上年同期为 10.0%, 上季度为 2.0%。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	二零二三年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	453,345	94.7 %	600,950	95.2 %	(147,605)	(24.6)%
其他	25,179	5.3 %	30,431	4.8 %	(5,252)	(17.3)%
销售收入总额	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度 94.7% 的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	二零二三年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	245,471	51.3 %	361,237	57.2 %	(115,766)	(32.0)%
12 吋晶圆	233,053	48.7 %	270,144	42.8 %	(37,091)	(13.7)%
销售收入总额	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.455 亿美元及 2.330 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	二零二三年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	385,519	80.5 %	489,269	77.5 %	(103,750)	(21.2)%
北美 ⁴	46,829	9.8 %	48,547	7.7 %	(1,718)	(3.5)%
亚洲 ⁵	28,137	5.9 %	45,186	7.2 %	(17,049)	(37.7)%
欧洲	17,173	3.6 %	39,965	6.3 %	(22,792)	(57.0)%
日本 ⁶	866	0.2 %	8,414	1.3 %	(7,548)	(89.7)%
销售收入总额	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度来自于中国的销售收入 3.855 亿美元，占销售收入总额的 80.5%，同比下降 21.2%，主要由于智能卡芯片的平均销售价格及需求下降，部分被逻辑、其他电源管理及 CIS 产品需求增加所抵消。
- 本季度来自于北美的销售收入 4,680 万美元，同比下降 3.5%，主要由于 MCU、逻辑、超级结及通用 MOSFET 产品的需求及平均销售价格下降，部分被其他电源管理产品的需求增加所抵消。
- 本季度来自于亚洲的销售收入 2,810 万美元，同比下降 37.7%，主要由于 MCU、逻辑及超级结产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,720 万美元，同比下降 57.0%，主要由于智能卡芯片、IGBT 及通用 MOSFET 产品的需求下降。
- 本季度来自于日本的销售收入 90 万美元，同比下降 89.7%，主要由于 MCU 及超级结产品的需求下降。

³包括中国大陆及中国香港。

⁴包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵不包括中国及日本。

⁶包括于 2013 年由一家总部位于美国的公司所收购的一家主要日本客户。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	二零二三年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	137,126	28.7 %	208,265	33.0 %	(71,139)	(34.2)%
独立式非易失性存储器	23,675	4.9 %	33,360	5.3 %	(9,685)	(29.0)%
分立器件	152,371	31.8 %	251,351	39.8 %	(98,980)	(39.4)%
逻辑及射频	63,487	13.3 %	57,175	9.1 %	6,312	11.0 %
模拟与电源管理	101,137	21.1 %	80,453	12.7 %	20,684	25.7 %
其他	728	0.2 %	777	0.1 %	(49)	(6.3)%
销售收入总额	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.371 亿美元，同比下降 34.2%，主要由于 MCU 产品的平均销售价格下降及智能卡芯片的需求下降。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 2,370 万美元，同比下降 29.0%，主要由于闪存产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度分立器件销售收入 1.524 亿美元，同比下降 39.4%，主要由于 IGBT、超级结产品的平均销售价格及需求下降，以及通用 MOSFET 产品的平均销售价格下降。
- 本季度逻辑及射频销售收入 6,350 万美元，同比增长 11.0%，主要得益于 CIS 及逻辑产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.011 亿美元，同比增长 25.7%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	二零二三年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
55nm 及 65nm	98,550	20.6 %	84,920	13.5 %	13,630	16.1 %
90nm 及 95nm	95,285	19.9 %	96,675	15.3 %	(1,390)	(1.4)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	68,660	14.3 %	120,254	19.0 %	(51,594)	(42.9)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	30,508	6.4 %	37,368	5.9 %	(6,860)	(18.4)%
0.25 μ m	2,436	0.5 %	6,319	1.0 %	(3,883)	(61.4)%
0.35 μ m 及以上	183,085	38.3 %	285,845	45.3 %	(102,760)	(35.9)%
销售收入总额	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工艺技术节点的销售收入 9,860 万美元，同比增长 16.1%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 9,530 万美元，同比下降 1.4%，主要由于智能卡芯片需求减少，部分被其他电源管理产品需求增加所抵消。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工艺技术节点的销售收入 6,870 万美元，同比下降 42.9%，主要由于 MCU 产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工艺技术节点的销售收入 3,050 万美元，同比下降 18.4%，主要由于 MCU 产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度 0.25 μ m 工艺技术节点的销售收入 240 万美元，同比下降 61.4%，主要由于逻辑及通用 MOSFET 产品的需求及平均销售价格下降。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工艺技术节点的销售收入 1.831 亿美元，同比下降 35.9%，主要由于 IGBT、超级结及其他电源管理产品的需求及平均销售价格下降，部分被通用 MOSFET 的需求增加所抵消。

销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	二零二三年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
电子消费品	298,320	62.4 %	347,824	55.1 %	(49,504)	(14.2)%
工业及汽车	110,643	23.1 %	195,158	30.9 %	(84,515)	(43.3)%
通讯	59,486	12.4 %	68,412	10.8 %	(8,926)	(13.0)%
计算机	10,075	2.1 %	19,987	3.2 %	(9,912)	(49.6)%
销售收入总额	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度电子消费品作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 2.983 亿美元，占销售收入总额的 62.4%，同比下降 14.2%，主要由于智能卡芯片及 IGBT 产品的平均销售价格及需求下降，部分被其他电源管理产品的需求增加所抵消。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.106 亿美元，同比下降 43.3%，主要由于 IGBT、MCU、通用 MOSFET、智能卡芯片及超级结产品的平均销售价格及需求下降。
- 本季度通讯产品销售收入 5,950 万美元，同比下降 13.0%，主要由于逻辑及模拟产品的需求下降。
- 本季度计算机产品销售收入 1,010 万美元，同比下降 49.6%，主要由于通用 MOSFET 及超级结产品的需求及平均销售价格下降。

产能⁷及产能利用率

晶圆厂(折合千片晶圆)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)
产能 (200mm)	178	178	178
产能 (300mm)	95	75	95
合计产能(折合 8 吋千片晶圆)	391	347	391
产能利用率 (200mm)	107.6%	112.0%	100.3%
产能利用率 (300mm)	89.3%	92.9%	84.2%
总体产能利用率	97.9%	102.7%	91.7%

- 本季度末月产能 391,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 97.9%，较上季度上升 6.2 个百分点。

⁷ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,106	1,074	1,026	3.0 %	7.8 %

■ 本季度付运晶圆 1,106,000 片，同比上升 3.0%，环比上升 7.8%。

经营开支分析

以千美元计	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,785	2,402	1,985	15.9 %	40.3 %
管理费用 ⁸	87,543	74,266	76,535	17.9 %	14.4 %
经营开支	90,328	76,668	78,520	17.8 %	15.0 %

■ 经营开支 9,030 万美元，同比上升 17.8%，主要由于新工厂华虹制造经营费用及研发工程片开支上升，环比上升 15.0%，主要由于人工开支增加。

其他收入/(损失)净额

以千美元计	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,558	3,921	3,560	(9.3)%	(0.1)%
利息收入	29,787	14,057	25,020	111.9 %	19.1 %
汇兑损失	(7,921)	(62,646)	(5,850)	(87.4)%	35.4 %
分占联营公司溢利	1,394	1,984	1,411	(29.7)%	(1.2)%
财务费用	(24,847)	(28,287)	(24,585)	(12.2)%	1.1 %
政府补贴	4,778	14,213	3,799	(66.4)%	25.8 %
其他	136	2,049	415	(93.4)%	(67.2)%
其他收入/(损失)净额	6,885	(54,709)	3,770	(112.6)%	82.6 %

■ 其他收入净额 690 万美元，上年同期为其他损失净额 5,470 万美元，主要由于汇兑损失减少及利息收入增加，环比上升 82.6%，主要由于利息收入增加，部分被汇兑损失增加所抵消。

⁸管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	96,890	161,190	40,660	(39.9)%	138.3 %
投资活动所用现金流量净额	(171,973)	(150,649)	(298,951)	14.2 %	(42.5)%
融资活动所得/(用)现金流量净额	416,148	(300,183)	789,913	(238.6)%	(47.3)%
外汇汇率变动影响净额	(25,185)	(77,948)	(8,817)	(67.7)%	185.6 %
现金及现金等价物变动影响净额	315,880	(367,590)	522,805	(185.9)%	(39.6)%

- 本季度经营活动所得现金流量净额 9,690 万美元，同比下降 39.9%，主要由于客户收款及政府补助减少所致，环比上升 138.3%，主要由于客户收款增加。
- 投资活动所用现金流量净额 1.720 亿美元，其中包括固定资产投资支出 1.968 亿美元，部分被收到利息收入 2,480 万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额 4.161 亿美元，其中非控股权益资本注资 4.924 亿美元，提取银行借款 9,900 万美元，及员工行权发行股份收到 50 万美元，部分被偿还银行借款本金 8,750 万美元，支付利息 4,980 万美元，支付股利 3,620 万美元，及支付租赁负债 230 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)
资产总额	12,104,780	11,648,010
负债总额	3,059,884	2,980,801
所有者权益总额	9,044,896	8,667,209
资产负债率 ⁹	25.3%	25.6%

资本开支

以千美元计	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第一季度 (未经审核)
华虹 8 吋	27,997	31,728
华虹无锡	40,431	71,417
华虹制造	128,402	199,429
合计	196,830	302,574

- 本季度资本开支 1.968 亿美元，其中 1.284 亿美元用于华虹制造，4,040 万美元用于华虹无锡，及 2,800 万美元用于华虹 8 吋。

⁹资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)
发展中物业	207,151	194,181
存货	462,563	431,206
贸易应收款项及应收票据	274,382	306,151
预付款项、其他应收款项及其他资产	75,761	53,242
应收关联方款项	16,034	15,688
已冻结存款及定期存款	39,259	32,032
现金及现金等价物	6,423,866	6,107,986
流动资产总额	7,499,016	7,140,486
贸易应付款项	246,206	239,261
其他应付款项及暂估费用	505,945	379,133
计息银行借款	247,034	232,201
租赁负债	4,674	6,257
政府补助	39,359	41,643
应付关联方款项	8,340	9,704
应付所得税	19,038	59,018
流动负债总额	1,070,596	967,217
净营运资金	6,428,420	6,173,269
速动比率	6.4x	6.7x
流动比率	7.0x	7.4x
贸易应收款项及应收票据周转天数	55	58
存货周转天数	94	92

- 存货由上季度末的 4.312 亿美元上升至本季度末的 4.626 亿美元，主要由于在制品增加。
- 贸易应收款项及应收票据由上季度末的 3.062 亿美元下降至本季度末的 2.744 亿美元，主要由于客户回款改善。
- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 5,320 万美元上升至本季度末的 7,580 万美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 3.791 亿美元上升至本季度末的 5.059 亿美元，主要由于应付资本开支增加。
- 应付所得税由上季度末的 5,900 万美元下降至本季度末的 1,900 万美元，主要由于本季度支付 2023 年度应交所得税，部分被本季度计提所得税开支所抵消。
- 净营运资金 本季度末 64.284 亿美元，流动比率 7.0。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 55 天。
- 存货周转天数 94 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)	于六月三十日 二零二三年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)
销售收入	478,524	631,381	459,986
销售成本	(428,461)	(456,325)	(430,354)
毛利	50,063	175,056	29,632
其他收入及收益	38,259	34,245	32,851
销售及分销费用	(2,785)	(2,402)	(1,985)
管理费用	(87,543)	(74,266)	(76,535)
其他费用	(7,921)	(62,651)	(5,907)
财务费用	(24,847)	(28,287)	(24,585)
分占联营公司溢利	1,394	1,984	1,411
税前(损失)/溢利	(33,380)	43,679	(45,118)
所得税(开支)/抵免	(8,368)	(35,845)	19,832
期内(损失)/溢利	(41,748)	7,834	(25,286)
以下各方应占利润			
母公司拥有人	6,673	78,524	31,818
非控股权益	(48,421)	(70,690)	(57,104)
持有人应占每股盈利			
基本	0.004	0.060	0.019
摊薄	0.004	0.060	0.019
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,716,917,408	1,308,028,146	1,716,634,650
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,720,532,998	1,318,619,081	1,718,334,991

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于六月三十日 二零二三年 (未经审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	3,750,176	3,587,363	3,256,562
投资物业	165,611	166,354	163,241
使用权资产	80,629	79,347	80,145
无形资产	42,320	46,526	31,170
于联营公司的投资	141,036	140,270	129,414
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	285,938	287,089	151,812
长期预付款项	139,425	200,074	40,937
递延税项资产	629	501	17,393
非流动资产总额	4,605,764	4,507,524	3,870,674
流动资产			
发展中物业	207,151	194,181	143,674
存货	462,563	431,206	558,252
贸易应收款项及应收票据	274,382	306,151	310,705
预付款项、其他应收款项及其他资产	75,761	53,242	32,194
应收关联方款项	16,034	15,688	16,803
已冻结存款及定期存款	39,259	32,032	167,077
现金及现金等价物	6,423,866	6,107,986	1,850,957
流动资产总额	7,499,016	7,140,486	3,079,662
流动负债			
贸易应付款项	246,206	239,261	227,907
其他应付款项及暂估费用	505,945	379,133	397,826
计息银行借款	247,034	232,201	385,746
租赁负债	4,674	6,257	4,477
政府补助	39,359	41,643	34,133
应付关联方款项	8,340	9,704	4,720
应付所得税	19,038	59,018	49,557
流动负债总额	1,070,596	967,217	1,104,366
流动资产净额	6,428,420	6,173,269	1,975,296
总资产减流动负债	11,034,184	10,680,793	5,845,970
非流动负债			
计息银行借款	1,964,956	1,993,525	1,410,544
租赁负债	19,440	17,714	18,312
递延税项负债	4,892	2,345	21,938
非流动负债总额	1,989,288	2,013,584	1,450,794
净资产	9,044,896	8,667,209	4,395,176
权益和负债权益			
股本	4,935,470	4,934,028	1,997,829
储备	1,333,799	1,389,777	1,130,367
本公司拥有人应占权益	6,269,269	6,323,805	3,128,196
非控股权益	2,775,627	2,343,404	1,266,980
权益总额	9,044,896	8,667,209	4,395,176

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于六月三十日	于六月三十日	于三月三十一日
	二零二四年 (未经审核)	二零二三年 (未经审核)	二零二四年 (未经审核)
经营活动所得现金流量:			
税前(亏损)/溢利	(33,380)	43,679	(45,118)
折旧及摊销	136,881	123,661	133,088
应占联营公司溢利	(1,394)	(1,984)	(1,411)
营运资金的变动及其它	(5,217)	(4,166)	(45,899)
经营活动所得现金流量净额	96,890	161,190	40,660
投资活动所用现金流量:			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(196,830)	(164,966)	(302,574)
投资其他权益工具	-	-	(17,618)
其他投资活动所得现金流量	24,857	14,317	21,241
投资活动所用现金流量净额	(171,973)	(150,649)	(298,951)
融资活动所得/(用)现金流量:			
非控股权益资本注资	492,450	-	689,430
提取银行贷款	99,042	8,116	103,405
发行股份所得收益	579	1,407	114
偿还银行贷款	(87,530)	(85,565)	-
已付利息	(49,800)	(52,720)	(2,155)
向股东支付股息	(28,876)	-	-
已抵押存款增加	(7,369)	(167,738)	-
支付租赁负债	(2,348)	(3,320)	(881)
其他融资活动所用现金流量	-	(363)	-
融资活动所得/(用)现金流量净额	416,148	(300,183)	789,913
现金及现金等价物增加/(减少)净额	341,065	(289,642)	531,622
外汇汇率变动影响净额	(25,185)	(77,948)	(8,817)
期初现金及现金等价物	6,107,986	2,218,547	5,585,181
期末现金及现金等价物	6,423,866	1,850,957	6,107,986

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

张素心(董事长)
唐均君(总裁)

非执行董事

叶峻
孙国栋
周利民
熊承艳

独立非执行董事

张祖同
王桂坝太平绅士
封松林

承董事会命

华虹半导体有限公司

张素心
董事长兼执行董事

中国 香港

二零二四年八月八日